

DO STYROPIANU

KOMBI DM

Mineralna zaprawa klejąca
do podłoży płytowych
i drewnopochodnych

GŁÓWNE ZALETY

- Wysoka siła klejenia
- Optymalna wytrzymałość mechaniczna
- Wysoka przyczepność do podłoży płytowych i styropianu
- Brak spływu z powierzchni pionowej
- Łatwy sposób aplikacji
- Zawiera mikrowłókna i włókna zbrojące
- Do stosowania z białym i grafitowym styropianem

ZASTOSOWANIE

Zaprawa mineralna przeznaczona do przyklejania izolacyjnych płyt ze styropianu EPS* do podłoży płytowych, w tym również drewnopochodnych w systemie ociepleń KABE THERM RENO** przy ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków o drewnianej konstrukcji szkieletowej. Do stosowania na podłożach płytowych wymienionych wg IGIMB-KOT-2024/0226 wydanie 2 i przeznaczonych do stosowania w warunkach wilgotnych wg normy PN-EN 13896. Zaprawa KOMBI DM może być stosowana w systemie klejonym z dodatkowym mocowaniem mechanicznym lub w systemie mocowanym mechanicznie z dodatkowym klejeniem w technologii złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków - ETICS.

DANE TECHNICZNE

Bazowy środek wiążący: spoiwa hydrauliczne z dodatkiem mineralnych i polimerowych modyfikatorów;

Gęstość objętościowa: ok. 1,57 g/cm³;

Proporcje mieszania: ok. 6,0 l wody na 25 kg zaprawy;

Okres przydatności do użycia po zarobieniu wodą: ok. 2 godzin;

Czas otwartego schnięcia: ≥ 20 min.

Barwa: jasnoszara;

Zużycie: ok. 4,0 kg/m². Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.

Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +5°C do +25°C;

Opakowania: Jednorazowe opakowanie papierowe zawierające 25 kg produktu.

Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu suchym, zapewniającym ochronę przed wilgocią i mrozem.

Uwaga: Produkt zabezpieczyć przed dostępem dzieci.

Okres przydatności do stosowania: 12 miesięcy od daty produkcji podane na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

SPOSÓB UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże do przyklejania płyt izolacyjnych musi być nośne, odłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego lub chemicznego. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkażić preparatem ALGIZID. Podłoże musi być zabezpieczone przed podciąganiem kapilarnym wilgoci i przed przeciekaniem wód pochodzących z opadów atmosferycznych. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: tłuszcz, pył, kurz, brud, trociny) trzeba usunąć. Zabrudzone podłoże umyć i odłuszczyć wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych na podłożach niepewnych należy wykonać próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku (8-10) próbek styropianu (o wym. 10 x 10 cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoża konieczne jest oczyszczenie podłoża ze słabo związanych warstw i zagruntowanie preparatem BUDOGRUNT SG. Po wyschnięciu preparatu należy wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne lub specjalne przygotowanie podłoża.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY: Do pojemnika z odmierzoną ilością chłodnej wody (ok. 6,0 litrów) stopniowo wsympać całą zawartość opakowania stale mieszając (mieszarką/wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem), aż do uzyskania jednorodnej masy wolnej od grudek. Po odczekaniu 5 minut i ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia. Okres przydatności do stosowania zarobionej wodą zaprawy wynosi ok. 2 godzin (w temperaturze otoczenia +20°C).

PRZYKLEJANIE PŁYT ZE STYROPIANU: Na podłożach płytowych i drewnopochodnych przyklejać płyty ze styropianu metodą płaszczynową. W tym celu należy nałożyć na płytę porcję zaprawy klejącej i wykorzystując prostą krawędź pacy równomiernie rozprowadzić cienką warstwą. Przy wykonywaniu tej czynności zaprawę należy dociskać pacą do powierzchni płyty. Następnie nanieść na płytę dodatkową porcję zaprawy i rozprowadzić żąbkowaną krawędzią pacy (o min. wymiarach zębów 10 x 10 mm). Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć tak, aby uzyskać równą powierzchnię z sąsiednimi płytami. Płyty należy przyklejać mijankowo, ściśle dosuwając do już wcześniej przyklejonych. Nadmiar wyciśniętej zaprawy usunąć, aby na obrzeżach płyty nie pozostały żadne resztki. Prawdopodobnie nałożona zaprawa powinna pokrywać całą powierzchnię płyty, a grubość warstwy zaprawy po przyklejeniu nie powinna przekraczać 1 cm. Po dostatecznym związaniu zaprawy (min. po 48 godzinach), przyklejone płyty można zamocować odpowiednimi łącznikami mechanicznymi, zgodnie z projektem ocieplenia. W celu uzyskania równej powierzchni zamocowanych płyt należy przeszlifować całą licową powierzchnię styropianu pacą z grubym papierem ściernym. Przy klejeniu płyt styropianowych na podłożach które nie są równe zaprawę klejącą-szpacłową należy nanosić na płyty metodą pasmowo-punktową. W tym celu przygotowaną zaprawę nanieść pasmami o szerokości 3÷6 cm na całym obwodzie wzdłuż zewnętrznych krawędzi płyty, oraz 3÷6 placzków zaprawy o średnicy 10÷15 cm równomiernie rozłożonych na środkowej części płyty. Nałożone na obrzeżu pasma zaprawy należy uformować w kształcie pryzmy, przeciągając pacą pod kątem 45° do powierzchni płyty. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć tak, aby uzyskać równą powierzchnię z sąsiednimi płytami. Płyty przyklejać mijankowo, ściśle dosuwając do już wcześniej przyklejonych. Nadmiar wyciśniętej zaprawy należy usunąć tak, aby na obrzeżach płyty nie pozostały żadne resztki. Prawdopodobnie nałożona zaprawa powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy zaprawy po przyklejeniu nie powinna przekraczać 1 cm. Po dostatecznym związaniu zaprawy (min. po 48 godzinach) przyklejone płyty można zamocować odpowiednimi łącznikami mechanicznymi, zgodnie z projektem ocieplenia. W celu uzyskania równej powierzchni zamocowanych płyt należy przeszlifować całą licową powierzchnię styropianu pacą z grubym papierem ściernym.

WYSYCHANIE: Okres schnięcia wykonanej warstwy klejącej wynosi min. 4 dni (przy wysychaniu w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%). Po upływie tego okresu można przejść do kolejnego etapu związanego z wykonaniem warstwy zbrojonej. **Uwaga:** Niska temperatura, wysoka wilgotność powietrza oraz niska wymiana powietrza mogą wydłużyć okres wysychania zaprawy.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: W celu uniknięcia pęknięć i nierówności, niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym. Podczas nakładania i wysychania zaprawy klejącej powinna panować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +5°C do +25°C. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia umyć wodą. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, przy ciepłym wietrze i wysokiej wilgotności powietrza. W celu ochrony niewyschniętej warstwy klejącej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek ochronnych.

Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, należy chronić oczy i skórę. W trakcie prac należy stosować ubrania robocze. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody, a przy wystąpieniu podrażnień zasięgnąć porady lekarza. Przed aplikacją należy zapoznać się z karta charakterystyki wyrobu.

* płyty styropianowe zastosowane w systemie ociepleń powinny spełniać wymogi techniczne podane w Krajowej Ocenie Technicznej na system ociepleń KABE THERM RENO.

** przy użyciu produktu w systemie ociepleń, producent udziela gwarancji jedynie w przypadku zastosowania wszystkich składników systemu KABE THERM RENO.